

专业承接PCBA板拆芯片加工翻新服务，宝安芯片翻新，IC翻新，QFN清洗，芯片洗脚

产品名称	专业承接PCBA板拆芯片加工翻新服务，宝安芯片翻新，IC翻新，QFN清洗，芯片洗脚
公司名称	深圳市卓汇芯科技有限公司
价格	2.80/个
规格参数	加工方式:来料加工 工艺:提供有铅、无铅 加工设备:回流焊，返修台，加热台，植球台，编带机等
公司地址	深圳市宝安区西乡街道桃源社区广深路西乡段300号齐粤印机大厦2层A
联系电话	0755-36979941 15220066551

产品详情

【公司介绍】

深圳市卓汇芯科技有限公司是一家集研发、生产、销售和加工服务为一体的技术型企业。

【服务项目】

1、承接：BGA/QFN/QFP/DIP/FPC/SOP/POP封装ic拆板、清洗、除锡、植锡、植球、整平、整脚、去氧化、打字、摆盘、编带等

DDR/EMMC/CPU/SSD/FLASH/CMOS等系列芯片批量拆卸、除胶、植球、装盘等，加工后可直接SMT贴片。

旧线路板拆料、报废电路板拆料、芯片拆卸回收利用。

2、销售：BGA除锡机、BGA植球机，BGA返修台，BGA熔锡台、BGA烤箱、有铅/无铅BGA锡球，BGA专用助焊膏，有铅/无铅锡膏等

3、定做：BGA手工植球治具、SMT钢网、印锡钢网、BGA植球钢网、BGA测试架等。

【服务流程】

- 1、发样品图片，我司确认IC类型和封装，确认拆卸/处理需求。
- 2、我司根据贵司的样品图片和加工需求，做报价单。
- 3、贵司来料，我司收到货后核对数量，排交期，上线。
- 4、我司如期做完，处理好的IC发货给贵司并结算货款。

【服务收费】

根据不同芯片的封装类型、尺寸、引脚/锡球数量和密度的不同报价。返修的难度越高、效率越低的芯片，价格会相对越高；返修难度低、效率高的芯片，价格会越低。

【服务优势】

我们有专业的团队、成熟的工艺技术、完善的流程管理、严格的品质管控！能够高良率、高效率、高产能的为您提供一站式服务！